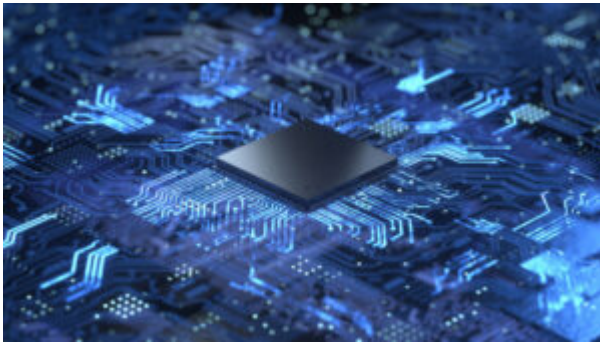


TSMC: Welcome to Silicon Saxony



Dresden. Der Halbleiterhersteller TSMC aus Taiwan hat angekündigt, gemeinsam mit Bosch, Infineon und NXP eine Halbleiterfabrik in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden errichten zu wollen. Geplant ist die Errichtung einer Halbleiterfabrik im Bereich des Dresdner Airport Parks. Das Produktionsvolumen soll 40.000 Wafer pro Monat in der Technologie 12-28 Nanometer betragen. Etwa 2.000 neue Arbeitsplätze sollen so dauerhaft entstehen. Laut den Unternehmen ist der Produktionsstart für das Ende des Jahres 2027 geplant. Die Hälfte der Investitionskosten in Höhe von etwa 10 Milliarden Euro wird erneut der Staat beisteuern.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer betonte: "Sachsen bietet für eine solche Ansiedlung beste Bedingungen – ein einzigartiges Halbleiter-Ökosystem, die enge Vernetzung mit Wissenschaft, Forschung und weiteren Wachstumsbranchen sowie das hier gebündelte Wissen und Können der Menschen. Die Entscheidung ist das Ergebnis eines mehrjährigen vertrauensvollen Verhandlungs- und Gesprächsprozesses." Die hohe Subventionierung dieser Ansiedlung mit etwa fünf Milliarden Euro sieht der Präsident des Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle Prof. Reint Gropp kritisch. Er plädiert dafür, wie schon bei den vorangegangenen Chipherstelleransiedlungen, nicht Produktion, sondern Innovation zu subventionieren.